

# 2024-2030年中国集成电路 封装市场深度分析与投资可行性报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2024-2030年中国集成电路封装市场深度分析与投资可行性报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/416252.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2024-2030年中国集成电路封装市场深度分析与投资可行性报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。 报告目录： 第1章：中国集成电路封装行业发展背景 1 1.1 集成电路封装行业定义及分类 1 1.1.1 集成电路封装行业定义 1 1.1.2 集成电路封装行业产品大类 1 1.1.3 集成电路封装行业特性分析 11 （1）行业周期性 11 （2）行业区域性 11 （3）行业季节性 11 1.1.4 集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析 11 我国在集成电路领域首先发展的即是封装测试业，由于具备成本和地缘优势，我国半导体封装测试企业快速成长，同时国外半导体公司也向中国大举转移封装测试产能，目前我国已经成为中国主要封装基地之一。封装测试业已成为中国半导体产业的主体，在技术上也开始向国际先进水平靠拢。 1.2 集成电路封装行业政策环境分析 12 1.2.1 行业管理体制 12 1.2.2 行业相关政策 12 1.3 集成电路封装行业经济环境分析 15 1.3.1 国际宏观经济环境及影响分析 15 （1）国际宏观经济现状 15 （2）国际宏观经济环境对行业影响分析 16 1.3.2 国内宏观经济环境及影响分析 17 （1）GDP增长情况分析 17 （2）居民收入水平 17 1.4 集成电路封装行业技术环境分析 18 1.4.1 集成电路封装技术演进分析 18 1.4.2 集成电路封装形式应用领域 19 1.4.3 集成电路封装工艺流程分析 19 1.4.4 集成电路封装行业新技术动态 20 第2章：中国集成电路产业发展分析 21 2.1 集成电路产业发展状况 21 2.1.1 集成电路产业链简介 21 集成电路产业链条主要包括：IC设计和光罩制造、IC制造以及IC测试、封装。 2.1.2 集成电路产业发展现状分析 21 （1）行业发展势头良好 21 （2）行业技术水平快速提升 21 （3）行业竞争力仍有待加强 22 （4）产业结构进一步优化 22 2.1.3 集成电路产业区域发展格局分析 22 （1）三大区域集聚发展格局业已形成 22 （2）整体呈现“一轴一带”的分布特征 23 （3）产业整体将“有聚有分，东进西移” 23 2.1.4 集成电路产业面临的发展机遇 23 （1）产业政策环境进一步向好 23 （2）战略性新兴产业将加速发展 24 （3）资本市场将为企业融资提供更多机会 24 2.1.5 集成电路产业面临的主要问题 24 （1）规模小 24 （2）创新不足 25 （3）价值链整合不够 25 （4）产业链不完善 25 2.1.6 集成电路产业发展预测 26 2.2 集成电路设计业发展状况 26 2.2.1 集成电路设计业发展概况 26 2.2.2 集成电路设计业发展特征 26 （1）产业规模持续扩大 26 （2）质量上升数量下降 27 （3）企业规模持续扩大 27 （4）技术能力大幅提升 28 2.2.3 集成电路设计业发展隐忧 29 2.2.4 集成电路设计业新发展策略 31 2.2.5 集成电路设计业发展预测 33 2.3 集成电路制造业发展状况 35 2.3.1 集成电路制造业发展现状分析 35 （1）集成电路制造业发展总体概况 35 （2）集成电路制造业发展主要特点 36 （3）集成电路制造

业规模及财务指标分析 38 2.3.2 集成电路制造业经济指标分析 40 (1) 集成电路制造业主要经济效益影响因素 40 (2) 集成电路制造业经济指标分析 41 (3) 不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析 41 (4) 不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析 41 (5) 不同地区企业经济指标分析 42 2.3.3 集成电路制造业供需平衡分析 42 (1) 全国集成电路制造业供给情况分析 42 (2) 全国集成电路制造业需求情况分析 43 (3) 全国集成电路制造业产销率分析 44 2.3.4 集成电路制造业发展预测 44 第3章：中国集成电路封装行业发展分析 46 3.1 中国集成电路封装行业整体发展情况 46 3.1.1 集成电路封装行业规模分析 46 3.1.2 集成电路封装行业发展现状分析 46 3.1.3 集成电路封装行业利润水平分析 46 3.1.4 大陆厂商与业内领先厂商的技术比较 47 3.1.5 集成电路封装行业影响因素分析 47 (1) 有利因素 47 (2) 不利因素 48 3.1.6 集成电路封装行业发展趋势及前景预测 48 (1) 发展趋势分析 48 (2) 前景预测 48 3.2 半导体封装发展情况分析 49 3.2.1 半导体行业发展概况 49 3.2.2 半导体行业景气预测 50 3.2.3 半导体封装发展分析 50 (1) 封装环节产值逐年成长 50 (2) 封装环节外包是未来发展趋势 50 3.3 集成电路封装类专利分析 51 3.3.1 专利分析样本构成 51 (1) 数据库选择 51 (2) 检索方式 51 3.3.2 专利发展情况分析 51 (1) 专利申请数量趋势 51 (2) 专利公开数量趋势 51 (3) 技术类型情况分析 52 (4) 技术分类趋势分布 52 (5) 主要权利人分布情况 52 3.4 集成电路封装过程部分技术问题探讨 52 3.4.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策 52 (1) 封装开裂的影响因素分析 52 (2) 管控影响开裂的因素的方法分析 53 3.4.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策 53 (1) 产生芯片弹坑问题的因素分析 53 (2) 预防芯片弹坑问题产生的方法 54 第4章：中国集成电路封装行业市场需求分析 55 4.1 集成电路市场分析 55 4.1.1 集成电路市场规模 55 4.1.2 集成电路市场结构分析 55 (1) 集成电路市场产品结构分析 55 (2) 集成电路市场应用结构分析 56 4.1.3 集成电路市场竞争格局 57 4.1.4 集成电路国内市场自给率 57 4.1.5 集成电路市场发展预测 57 4.2 集成电路封装行业需求分析 58 4.2.1 计算机领域对行业的需求分析 58 (1) 计算机市场发展现状 58 (2) 集成电路在计算机领域的应用 59 (3) 计算机领域对行业需求的拉动 59 4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析 60 (1) 消费电子市场发展现状 60 (2) 集成电路在消费电子领域的应用 61 (3) 消费电子领域对行业需求的拉动 61 4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析 61 (1) 通信设备市场发展现状 61 (2) 集成电路在通信设备领域的应用 61 (3) 通信设备领域对行业需求的拉动 62 4.2.4 工控设备领域对行业的需求分析 62 (1) 工控设备市场发展现状 62 (2) 集成电路在工控设备领域的应用 63 (3) 工控设备领域对行业需求的拉动 63 4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析 63 (1) 汽车电子市场发展现状 63 (2) 集成电路在汽车电子领域的应用 64 (3) 汽车电子领域对行业需求的拉动 65 4.2.6 其他应用领域对行业的需求分析 66 第5章：集成电路封装行业市场竞争分析 67 5.1 集成电路封装行业国际竞争格局分析 67 5.1.1 国际集成电路封装市场总体发展状况 67 5.1.2

国际集成电路封装市场竞争状况分析 68 5.1.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析 69 (1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本 69 (2) 主板材料的变化趋势 70 5.1.4 跨国企业在华市场竞争力分析 70 (1) 台湾日月光集团竞争力分析 70 (2) 美国安靠 (Amkor) 公司竞争力分析 72 (3) 台湾矽品公司竞争力分析 74 (4) 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析 76 (5) 力成科技股份有限公司竞争力分析 78 (6) 飞思卡尔公司竞争力分析 82 (7) 英飞凌科技公司竞争力分析 84 5.2 集成电路封装行业国内竞争格局分析 86 5.2.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析 86 5.2.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析 86 5.3 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析 87 5.3.1 现有竞争者之间的竞争 87 5.3.2 上游议价能力分析 87 5.3.3 下游议价能力分析 87 5.3.4 行业潜在进入者分析 87 5.3.5 替代品风险分析 88 5.3.6 行业竞争五力模型总结 88 第6章：中国集成电路封装行业产品市场分析 89 6.1 集成电路封装行业BGA产品市场分析 89 6.1.1 BGA封装技术 89 6.1.2 BGA产品主要应用领域 89 6.1.3 BGA产品需求拉动因素 89 6.1.4 BGA产品市场应用现状分析 89 6.1.5 BGA产品市场前景展望 89 6.2 集成电路封装行业SIP产品市场分析 90 6.2.1 SIP封装技术 90 6.2.2 SIP产品主要应用领域 91 6.2.3 SIP产品需求拉动因素 92 6.2.4 SIP产品市场应用现状分析 93 6.2.5 SIP产品市场前景展望 93 6.3 集成电路封装行业SOP产品市场分析 94 6.3.1 SOP封装技术 94 6.3.2 SOP产品主要应用领域 94 6.3.3 SOP产品市场发展现状 94 6.3.4 SOP产品市场前景展望 95 6.4 集成电路封装行业QFP产品市场分析 95 6.4.1 QFP封装技术 95 6.4.2 QFP产品主要应用领域 95 6.4.3 QFP产品市场发展现状 95 6.4.4 QFP产品市场前景展望 96 6.5 集成电路封装行业QFN产品市场分析 96 6.5.1 QFN封装技术 96 6.5.2 QFN产品主要应用领域 96 6.5.3 QFN产品市场发展现状 97 6.5.4 QFN产品市场前景展望 97 6.6 集成电路封装行业MCM产品市场分析 97 6.6.1 MCM封装技术水平概况 97 (1) 概念简介 97 (2) MCM封装分类 97 6.6.2 MCM产品主要应用领域 98 6.6.3 MCM产品需求拉动因素 98 6.6.4 MCM产品市场发展现状 99 6.6.5 MCM产品市场前景展望 100 6.7 集成电路封装行业CSP产品市场分析 100 6.7.1 CSP封装技术水平概况 100 (1) 概念简介 100 (2) CSP产品特点 100 (3) CSP封装分类 101 6.7.2 CSP产品主要应用领域 102 6.7.3 CSP产品市场发展现状 102 6.7.4 CSP产品市场前景展望 102 6.8 集成电路封装行业其他产品市场分析 103 6.8.1 晶圆级封装市场分析 103 (1) 概念简介 103 (2) 产品特点 103 (3) 主要应用领域 103 (4) 市场规模与主要供应商 104 (5) 前景展望 105 6.8.2 覆晶/倒封装市场分析 105 (1) 概念简介 105 (2) 产品特点 105 (3) 市场前景 105 6.8.3 3D封装市场分析 106 (1) 概念简介 106 (2) 封装方法 106 (3) 封装特点 106 (4) 发展现状与前景 106 第7章：中国集成电路封装行业主要企业经营分析 108 7.1 集成电路封装企业发展总体状况分析 108 7.1.1 集成电路封装行业制造商销售收入排名 108 7.1.2 集成电路封装行业制造商利润总额排名 108 7.2 集成电路封装行业领先企业个案分析 108 7.2.1 飞思卡尔半导体 (中国) 有限公司经营情况分析 108 (1) 企业发展简况分析

108 (2) 企业产销能力分析 109 (3) 企业盈利能力分析 109 (4) 企业运营能力分析 109  
(5) 企业偿债能力分析 109 (6) 企业发展能力分析 109 (7) 企业产品结构及新产品动向  
110 (8) 企业销售渠道与网络 110 (9) 企业经营状况优劣势分析 110 7.2.2 威讯联合半导体  
(北京)有限公司经营情况分析 110 (1) 企业发展简况分析 110 (2) 企业产销能力分析 111  
(3) 企业盈利能力分析 111 (4) 企业运营能力分析 111 (5) 企业偿债能力分析 111 (6)  
企业发展能力分析 111 (7) 企业产品结构及新产品动向 112 (8) 企业销售渠道与网络 112  
(9) 企业经营状况优劣势分析 112 7.2.3 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析 112 (1)  
企业发展简况分析 112 (2) 企业产销能力分析 112 (3) 企业盈利能力分析 114 (4) 企业运  
营能力分析 115 (5) 企业偿债能力分析 115 (6) 企业发展能力分析 115 (7) 企业产品结构  
及新产品动向 115 (8) 企业销售渠道与网络 116 (9) 企业经营状况优劣势分析 116 7.2.4 上  
海松下半导体有限公司经营情况分析 117 (1) 企业发展简况分析 117 (2) 企业产销能力分  
析 118 (3) 企业盈利能力分析 118 (4) 企业运营能力分析 118 (5) 企业偿债能力分析 118  
(6) 企业发展能力分析 119 (7) 企业产品结构及新产品动向 119 (8) 企业销售渠道与网络  
119 (9) 企业经营状况优劣势分析 119 7.2.5 深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析 119  
(1) 企业发展简况分析 119 (2) 企业产销能力分析 119 (3) 企业盈利能力分析 120 (4)  
企业运营能力分析 120 (5) 企业偿债能力分析 120 (6) 企业发展能力分析 120 (7) 企业产  
品结构及新产品动向 120 (8) 企业销售渠道与网络 120 (9) 企业经营状况优劣势分析 121  
第8章：中国集成电路封装行业投资分析及建议 122 8.1 集成电路封装行业投资特性分析 122  
8.1.1 集成电路封装行业进入壁垒 122 (1) 技术壁垒 122 (2) 资金壁垒 122 (3) 人才壁垒  
122 (4) 严格的客户认证制度 122 8.1.2 集成电路封装行业盈利模式 123 专业的封装测试企业  
，由于其采取代工的经营模式，通常采用成本加成的定价方式，整体上毛利率趋于稳定，但  
也随着半导体行业的景气状况变化而呈现相应的波动。 8.1.3 集成电路封装行业盈利因素 123  
8.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析 123 8.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概  
况 123 8.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析 124 8.2.3 国内集成电路封装企业  
投资兼并与重组整合分析 125 (1) 通富微电公司投资兼并与重组分析 125 (2) 华天科技公  
司投资兼并与重组分析 125 (3) 长电科技公司投资兼并与重组分析 125 8.2.4 集成电路封装行  
业投资兼并与重组整合趋势分析 126 8.3 集成电路封装行业投融资分析 127 8.3.1 电子发展基金  
对集成电路产业的扶持分析 127 (1) 电子发展基金对集成电路产业的扶持情况 127 (2) 电  
子发展基金对集成电路产业的扶持建议 128 8.3.2 集成电路封装行业融资成本分析 129 8.3.3 半  
导体行业资本支出分析 130 8.4 集成电路封装行业投资建议 130 8.4.1 集成电路封装行业投资机  
会分析 130 8.4.2 集成电路封装行业投资风险分析 131 8.4.3 集成电路封装行业投资建议 131 (1  
) 投资区域建议 131 (2) 投资产品建议 131 (3) 技术升级建议 132

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/416252.html>